

## 株式会社東京精密 2017 年度(平成 30 年 3 月期) 決算説明会

### 質疑応答 要約

2018 年 5 月 15 日 開催

- 本資料は、2018 年 5 月 15 日に開催された 2017 年度決算説明会の質疑応答の内容を、当社の判断で要約したものです。
  - 本資料に記載されている情報は、決算説明会開催日時時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
1. 足許の半導体製造装置受注についての動向、台湾 OSAT(Outsourced Assembly and Testing)メーカーの需要動向を聞きたい。
    - 当社の状況に限るが、2018 年 4、5 月は検査装置(プローバ)や、ダイサを中心に堅調な受注動向であったものの、半導体デバイス分野によって需要の強弱があり、サーバ関連の装置需要は強く、他は軟調となっている。短期的には、例年同様 8 月頃に受注がボトムとなり、冬場迄までに回復すると想定している。また足許落ち込んでいるスマートフォン関連でも、ディスプレイドライバや高周波フィルタ分野など、一部では堅調な需要となっている。
    - 台湾 OSAT については、従前と比較するとやや弱い受注環境ではあるが、一方で既に多額の装置受注残高を有するお客様も存在する。
  2. 2017 年度第 4 四半期(2018 年 1-3 月)の半導体製造装置受注で、特に想定を上回る受注を獲得した製品は何か?
    - プローバ、及び一部の研削系製品の受注が想定を上振れた。
  3. 半導体製造装置で、顧客からの受注キャンセルや納期遅延要請などは発生しているか?
    - ほとんど起きていない。こうした動きの主因は、通常、複数社からの 2 重、3 重発注だが、防衛策として上流の需要動向を十分に把握して受注活動を行っている。ただし、今後の景気変動次第では現在の受注残高へのリスクが発生するので、注視したい。
  4. 半導体製造装置の需要拡大が期待される新技術は何か?
    - 拡大しているのは新材料専用の高剛性研削盤(HRG)。この装置は CMP(ChaMP)

とのセット販売ができるのでこれからの一層の拡大に期待している。TSV については、対応製品を有しているが、試作用途が中心であり、量産展開にはもう少し時間がかかると考える。

5. 精密切断ブレードの需要動向は?
  - 半導体製造装置セグメントの中で、スマートフォン関連の減産影響を最も受けているのが精密切断ブレードであり、2018年2、3月の月次受注高は、ピーク比で半減した。ただし、4、5月には受注は回復傾向に転じており、次期モデルの効果により7月頃には以前の水準に戻ることを期待している。
6. 従前の決算説明会で、メモリ向けプローバでの出遅れを示唆していたが、現状どうか。
  - 受注ベースではキャッチアップできている。
7. 半導体製造装置の生産状況、部材逼迫動向などについてコメントが欲しい。
  - 製品納期は長期化しており、プローバは6か月程度、ダイサも4、5か月程度となっている。一方で、2018年度上期半導体製造装置売上予想(337億円)を達成するための部材確保はできている。人材面では、一時と比較するとやや確保しやすくなった。
8. 決算説明会資料で触れている新工場の検討について、竣工時期、生産能力増強規模の見通しと、売上予想との関係を聞きたい。
  - 2018年度売上計画は現有の工場で達成可能と考えているが、更なる売上拡大のためには、早急な拡充が必要との認識である。新工場は、今後2年程度での竣工を目指し検討しており、これにより生産能力は何割か増加する見通し。竣工までの期間で生産が逼迫する場合は、賃貸工場の運用も想定している。
9. 2017年度業績説明で触れた特別賞与の総額と、2018年度業績予想での同種コストの織り込み度合を聞きたい。
  - 総額数億円。2018年度予想に同種コストは織り込んでいない。
10. 2018年度業績予想について、増収額の割に営業利益の増益水準が小さく見えるが、部材調達コストの増加を織り込んでいるのか?
  - 2018年度予想には、人件費、開発費、不動産経費、ERP導入経費などの増加要因を織り込んでいる。
11. 中期目標(2020年度迄に営業利益 220 億円)の前提となる売上高 1,100 億円の事業セグ

メント別構成比とその成長要因、特に計測事業での拡大計画と、EV(電気自動車)市場拡大に伴うリスクの織り込み度合を聞きたい。

- 売上構成比は、半導体製造装置/計測機器で、概ね 2:1 の構成を想定している。半導体製造装置市場は、今後数年右肩上がりの需要動向を想定している。計測機器についても、市場は拡大基調にあるので、現在の戦略を踏襲して進めてゆくと同時に、市場シェアを上げる計画も織り込んでいる。
- 計測機器セグメントでは、市場に認知されつつある光計測製品の売上増加と、海外展開の拡大を通じて、売上増加を図りたい。
- 自動車業界は EV への大きな転換期にあるが、モノづくりに計測は必須であるので、EV 関連の計測需要があらたに発生すると予想している。当社もこれに向けたアプリケーション開発に注力している。その一方で、中期目標の期間中は引き続き内燃機関自動車ラインに向けた投資が多く計画されていることから、引き続き内燃機関自動車向けを主流とした計測機器需要の増加を想定している。

## 12. 2018 年度の想定為替レートは?

- 2018 年度の前回は米ドル=105 円、ユーロ=130 円。為替変動の影響は、1 ドル 1 円の変動で 7, 8 千万円の影響と考えている。

以上